

Product Line-Up

BGA

Application : Smartphone, Wearable 등 소형 IT 기기



[Smart Phone Main Board]

1 AP (FCCSP) : 스마트폰의 프로세서 (두뇌 역할)

· AP Die가 Bump를 통해 기판과 전기적 연결



FCCSP

2 Memory (UTCSP) : 기억장치 (작업공간 혹은 저장장치 역할)

· Memory Die가 Wire로 기판과 전기적으로 연결



WB-CSP

3 RFFE (SiP) : 디바이스가 통신을 통해 정보 교환이 가능케 하는 역할

· 다수의 통신 칩과 수동소자들이 모듈로 통합



SiP

FCBGA

Application : CPU, GPU, Server, Automotive, Network 등



[PC Main Board]

[Graphic Card]

1 CPU : PC와 같은 디바이스의 중앙처리장치 (두뇌역할)

GPU : 영상정보를 처리하거나 화면 출력을 담당하는 연산처리장치

· Chip과 Main Board를 연결하는 패키지 기판
· 대용량 고속 Data 처리 대응



FCBGA